

产品说明书

石蜡包埋组织芯片的制作

货号：HL-service-1-9

产品名称	石蜡包埋组织芯片的制作	
产品介绍	石蜡包埋组织芯片的制备分为以下核心步骤：	
	1、芯片设计与受体蜡块制备 依据研究需求设计微阵列布局（通常为24-160个样本点），采用慧蓝生物受体蜡块（货号：HL-TC-02），并在其表面规划阵列孔位。	
	2、组织芯采集与定位 使用组织芯片取样针在供体蜡块上精准提取圆柱形组织芯（直径与受体孔径匹配），确保目标区域定位准确。	
	3、组织芯片阵列排布 将采集的组织芯片按预设顺序插入受体蜡块孔位中。通过铜板加热（55℃）使组织芯与受体蜡块半融合，确保排布稳定性。	
	4、融合与固化 将排布完成的蜡块融合，随后冷却固化形成一体化结构。	
	多孔径规格可选：	
	孔径大小	排布
5.0mm	4*6	24
3.0mm	6*9	54
2.5mm	7*11	77
2.0mm	8*12	96
1.5mm	11*17	178

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com